

2020-2026年中国集成电路 产业发展现状与市场前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路产业发展现状与市场前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202008/180864.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路是在同一块半导体材料上，利用各种不同的加工方法，同时制作出许多极其微小的电阻、电容及晶体管等电路元器件，并将它们相互连接起来，使之具有特定的电路功能。半导体集成电路是20世纪60年代开始发展起来的一种新型电子元器件，它具有体积小、重量轻、可靠性高以及成本低廉等一系列优点，所以发展十分迅速，不仅在军事、航天等方面采用，而且在家用电器中也到处可见。近几年来，随着电子技术的迅猛发展，集成电路已大量进入现代电子技术领域。2018年1-10月中国集成电路产量及同比增长走势

中企顾问网发布的《2020-2026年中国集成电路产业发展现状与市场前景预测报告》共八章。首先介绍了中国集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了中国集成电路行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资中国集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1集成电路封装行业定义及分类

1.1.1集成电路封装行业定义

1.1.2集成电路封装行业产品大类

1.1.3集成电路封装行业特性分析

（1）行业周期性

（2）行业区域性

（3）行业季节性

1.1.4集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

1.2集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1行业管理体制

1.2.2行业相关政策

1.3集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1国际宏观经济环境及影响分析

- (1) 国际宏观经济现状
- (2) 国际宏观经济环境对行业影响分析

1.3.2国内宏观经济环境及影响分析

- (1) GDP增长情况分析
- (2) 居民收入水平

1.4集成电路封装行业技术环境分析

1.4.1集成电路封装技术演进分析

1.4.2集成电路封装形式应用领域

1.4.3集成电路封装工艺流程分析

1.4.4集成电路封装行业新技术动态

第2章：中国集成电路产业发展分析

2.1集成电路产业发展状况

2.1.1集成电路产业链简介

2.1.2集成电路产业发展现状分析

- (1) 行业发展势头良好
- (2) 行业技术水平快速提升
- (3) 行业竞争力仍有待加强
- (4) 产业结构进一步优化

2.1.3集成电路产业区域发展格局分析

- (1) 三大区域集聚发展格局业已形成
- (2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征
- (3) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

2.1.4集成电路产业面临的发展机遇

- (1) 产业政策环境进一步向好
- (2) 战略性新兴产业将加速发展
- (3) 资本市场将为企业融资提供更多机会

2.1.5集成电路产业面临的主要问题

- (1) 规模小
- (2) 创新不足

(3) 价值链整合不够

(4) 产业链不完善

2.1.6集成电路产业“十三五”发展预测

2.2集成电路设计业发展状况

2.2.1集成电路设计业发展概况

2.2.2集成电路设计业发展特征

(1) 产业规模持续扩大

(2) 质量上升数量下降

(3) 企业规模持续扩大

(4) 技术能力大幅提升

2.2.3集成电路设计业发展隐忧

2.2.4集成电路设计业新发展策略

2.2.5集成电路设计业“十三五”发展预测

2.3集成电路制造业发展状况

2.3.1集成电路制造业发展现状分析2010-2018年中国集成电路产量及同比增长走势

(1) 集成电路制造业发展总体概况

(2) 集成电路制造业发展主要特点

(3) 集成电路制造所属行业规模及财务指标分析

1) 集成电路制造业规模分析

2) 集成电路制造业盈利能力分析

3) 集成电路制造业运营能力分析

4) 集成电路制造业偿债能力分析

5) 集成电路制造业发展能力分析

2.3.2集成电路制造业经济指标分析

(1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素

(2) 集成电路制造业经济指标分析

(3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析

(4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析

(5) 不同地区企业经济指标分析

2.3.3集成电路制造所属行业供需平衡分析

(1) 全国集成电路制造所属行业供给情况分析

1) 全国集成电路制造所属行业总产值分析

- 2) 全国集成电路制造所属行业产成品分析
 - (2) 全国集成电路制造所属行业需求情况分析
- 1) 全国集成电路制造所属行业销售产值分析
- 2) 全国集成电路制造所属行业销售收入分析
 - (3) 全国集成电路制造业产销率分析
- 2.3.4集成电路制造业“十三五”发展预测

第3章：中国集成电路封装所属行业发展分析

3.1中国集成电路封装所属行业整体发展情况

3.1.1集成电路封装所属行业规模分析

3.1.2集成电路封装所属行业发展现状分析

3.1.3集成电路封装行业利润水平分析

3.1.4大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

3.1.5集成电路封装行业影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

3.1.6集成电路封装行业发展趋势及前景预测

(1) 发展趋势分析

(2) 前景预测

3.2半导体封测发展情况分析

3.2.1半导体行业发展概况

3.2.2半导体行业景气预测

3.2.3半导体封装发展分析

(1) 封装环节产值逐年成长

(2) 封装环节外包是未来发展趋势

3.3集成电路封装类专利分析

3.3.1专利分析样本构成

(1) 数据库选择

(2) 检索方式

3.3.2专利发展情况分析

(1) 专利申请数量趋势

(2) 专利公开数量趋势

- (3) 技术类型情况分析
- (4) 技术分类趋势分布
- (5) 主要权利人分布情况
- 3.4集成电路封装过程部分技术问题探讨
- 3.4.1集成电路封装开裂产生原因分析及对策
 - (1) 封装开裂的影响因素分析
 - (2) 管控影响开裂的因素的方法分析
- 3.4.2集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策
 - (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析
 - (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第4章：中国集成电路封装所属行业市场需求分析

- 4.1集成电路市场分析
 - 4.1.1集成电路市场规模
 - 4.1.2集成电路市场结构分析
 - (1) 集成电路市场产品结构分析
 - (2) 集成电路市场应用结构分析
 - 4.1.3集成电路市场竞争格局
 - 4.1.4集成电路国内市场自给率
 - 4.1.5集成电路市场发展预测
- 4.2集成电路封装行业需求分析
 - 4.2.1计算机领域对行业的需求分析
 - (1) 计算机市场发展现状
 - (2) 集成电路在计算机领域的应用
 - (3) 计算机领域对行业需求的拉动
 - 4.2.2消费电子领域对行业的需求分析
 - (1) 消费电子市场发展现状
 - (2) 消费电子领域对行业需求的拉动
 - 4.2.3通信设备领域对行业的需求分析
 - (1) 通信设备市场发展现状
 - (2) 集成电路在通信设备领域的应用
 - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动

4.2.4工控设备领域对行业的需求分析

- (1) 工控设备市场发展现状
- (2) 集成电路在工控设备领域的应用
- (3) 工控设备领域对行业需求的拉动

4.2.5汽车电子领域对行业的需求分析

- (1) 汽车电子市场发展现状
- (2) 集成电路在汽车电子领域的应用
- (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动

4.2.6其他应用领域对行业的需求分析

第5章：集成电路封装行业市场竞争分析

5.1集成电路封装行业国际竞争格局分析

5.1.1国际集成电路封装市场总体发展状况

5.1.2国际集成电路封装市场竞争状况分析

5.1.3国际集成电路封装市场发展趋势分析

- (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本
- (2) 主板材料的变化趋势

5.1.4跨国企业在华市场竞争力分析

- (1) 台湾日月光集团竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

- (2) 美国安靠（Amkor）公司竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

- (3) 台湾矽品公司竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 力成科技股份有限公司竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

(6) 飞思卡尔公司竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

(7) 英飞凌科技公司竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析

5.2.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析

5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析

5.3 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

5.3.1 现有竞争者之间的竞争

5.3.2 上游议价能力分析

5.3.3 下游议价能力分析

5.3.4 行业潜在进入者分析

5.3.5 替代品风险分析

5.3.6 行业竞争五力模型总结

第6章：中国集成电路封装行业产品市场分析

6.1 集成电路封装行业BGA产品市场分析

6.1.1 BGA封装技术

6.1.2 BGA产品主要应用领域

6.1.3 BGA产品需求拉动因素

6.1.4 BGA产品市场应用现状分析

6.1.5 BGA产品市场前景展望

6.2 集成电路封装行业SIP产品市场分析

6.2.1 SIP封装技术

6.2.2 SIP产品主要应用领域

6.2.3 SIP产品需求拉动因素

6.2.4 SIP产品市场应用现状分析

6.2.5 SIP产品市场前景展望

6.3 集成电路封装行业SOP产品市场分析

6.3.1 SOP封装技术

6.3.2 SOP产品主要应用领域

6.3.3 SOP产品市场发展现状

6.3.4 SOP产品市场前景展望

6.4 集成电路封装行业QFP产品市场分析

6.4.1 QFP封装技术

6.4.2 QFP产品主要应用领域

6.4.3 QFP产品市场发展现状

6.4.4 QFP产品市场前景展望

6.5 集成电路封装行业QFN产品市场分析

6.5.1 QFN封装技术

6.5.2 QFN产品主要应用领域

6.5.3 QFN产品市场发展现状

6.5.4 QFN产品市场前景展望

6.6 集成电路封装行业MCM产品市场分析

6.6.1 MCM封装技术水平概况

(1) 概念简介

(2) MCM封装分类

6.6.2MCM产品主要应用领域

6.6.3MCM产品需求拉动因素

6.6.4MCM产品市场发展现状

6.6.5MCM产品市场前景展望

6.7集成电路封装行业CSP产品市场分析

6.7.1CSP封装技术水平概况

(1) 概念简介

(2) CSP产品特点

(3) CSP封装分类

6.7.2CSP产品主要应用领域

6.7.3CSP产品市场发展现状

6.7.4CSP产品市场前景展望

6.8集成电路封装行业其他产品市场分析

6.8.1晶圆级封装市场分析

(1) 概念简介

(2) 产品特点

(3) 主要应用领域

(4) 市场规模与主要供应商

(5) 前景展望

6.8.2覆晶/倒封装市场分析

(1) 概念简介

(2) 产品特点

(3) 市场前景

6.8.33D封装市场分析

(1) 概念简介

(2) 封装方法

(3) 封装特点

(4) 发展现状与前景

第7章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析

7.1集成电路封装企业发展总体状况分析

7.1.1集成电路封装行业制造商销售收入排名

- 7.1.2集成电路封装行业制造商利润总额排名
- 7.2集成电路封装行业领先企业个案分析
 - 7.2.1飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析
 - (1) 企业发展简况分析149
 - (2) 企业经营情况分析151
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - 7.2.2威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析
 - (1) 企业发展简况分析154
 - (2) 企业经营情况分析155
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - 7.2.3江苏长电科技股份有限公司经营情况分析
 - (1) 企业发展简况分析158
 - (2) 企业经营情况分析159
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - 7.2.4上海松下半导体有限公司经营情况分析
 - (1) 企业发展简况分析162
 - (2) 企业经营情况分析163
 - (3) 企业经营优劣势分析
 - 7.2.5深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析
 - (1) 企业发展简况分析166
 - (2) 企业经营情况分析167
 - (3) 企业经营优劣势分析

第8章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

- 8.1集成电路封装行业投资特性分析
 - 8.1.1集成电路封装行业进入壁垒
 - (1) 技术壁垒
 - (2) 资金壁垒
 - (3) 人才壁垒
 - (4) 严格的客户认证制度
 - 8.1.2集成电路封装行业盈利模式
 - 8.1.3集成电路封装行业盈利因素

8.2	集成电路封装行业投资兼并与重组分析
8.2.1	集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况
8.2.2	国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
8.2.3	国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
(1)	通富微电公司投资兼并与重组分析
(2)	华天科技公司投资兼并与重组分析
(3)	长电科技公司投资兼并与重组分析
8.2.4	集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析
8.3	集成电路封装行业投融资分析
8.3.1	电子发展基金对集成电路产业的扶持分析
(1)	电子发展基金对集成电路产业的扶持情况
(2)	电子发展基金对集成电路产业的扶持建议
8.3.2	集成电路封装行业融资成本分析
8.3.3	半导体行业资本支出分析
8.4	集成电路封装行业投资建议
8.4.1	集成电路封装行业投资机会分析
8.4.2	集成电路封装行业投资风险分析
8.4.3	集成电路封装行业投资建议
(1)	投资区域建议
(2)	投资产品建议
(3)	技术升级建议

图表目录：

图表1：集成电路封装行业产品分类

图表2：我国集成电路封装企业地区分布（单位：%）

图表3：2018年江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元）

图表4：2007年以来集成电路封装在集成电路产业中占比变化（单位：%）

图表5：集成电路封装行业主要政策分析

图表6：2018年发达经济体增长情况（单位：%）

图表7：2018年主要新兴经济体增长情况（单位：%）

图表8：2018年主要国家经济增长速度（单位：%）

图表9：2018年世界银行和IMF对于世界主要经济体的预测（单位：%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202008/180864.html>